# Fachausschuß Mikrosystemtechnik in der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik und Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V.

Vortragsveranstaltung

#### Mikrosystemtechnik

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart-Büsnau

16. Januar 1991

"Modellierung mikromechanischer Sensoren mit der Methode der Finiten Elemente"

Th.Fabula, B.Schmidt

Hahn-Schickard Institut für Mikro- und Informationstechnik, Villingen-Schwenningen

# Modellierung mikromechanischer Sensoren mit der Methode der Finiten Elemente

Th.Fabula, B.Schmidt

Hahn-Schickard-Institut für Mikro- und Informationstechnik, Villingen-Schwenningen

Im Hahn-Schickard-Institut wird das kommerzielle FEM-Programmsystem ANSYS für den Entwurf und die Auslegung von mikromechanischen Sensoren eingesetzt. Im Vordergrund stehen statische und dynamische Berechnungen an unterschiedlichen Sensorstrukturen, die z.T. anisotropes Materialverhalten (Silizium, Quarz) und den Einfluß verschiedener physikalischer Größen (z.B. Temperatur) berücksichtigen. Als Beispiele werden die Berechnungen von Silizium-Drucksensoren und von resonanten Quarz-Kraftsensoren aufgeführt.

Bei den statischen Berechnungen wird am Beispiel eines Drucksensors der Einfluß der Strukturgeometrie auf die Auslenkung und den Spannungszustand der Silizium-Membran aufgezeigt. Die Ergebnisse geben z.B. Aufschluß über eine günstige Anordnung der piezoresistiven Bauelemente, die Empfindlichkeit und den linearen Bereich des Drucksensors.

Bei den dynamischen Berechnungen sind die Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen (Modalanalyse), die Kraft-Frequenz-Kennlinie (Kraftempfindlichkeit) und das Frequenzgangverhalten (Amplitudenspektrum) bei resonanter Anregung des Kraftsensors von Interesse. Die Anregung der resonanten Sensoren erfolgt z.B. thermisch oder piezoelektrisch, so daß die Kopplung verschiedener Felder (Wärmefeld-Struktur, Piezoelektrizität etc.) mit berücksichtigt werden muß. Der Einfluß der Temperatur auf die Resonanzeigenschaften der Sensorstruktur können ebenfalls mit berücksichtigt werden.

# Hahn-Schickard-Institut für Mikro- und Informationstechnik, Villingen-Schwenningen

# Modellierung mikromechanischer Sensoren mit der Methode der Finiten Elemente

Th.Fabula, B.Schmidt

- A.) Statische Berechnungen am Beispiel eines piezoresistiven Silizium-Drucksensors
- B.) Dynamische Berechnung eines resonanten Kraftsensors auf Quarzbasis

# **Gliederung**

- A.) Statische FEM-Berechnungen
  - 2D FEM-Berechnung
  - Nichtlineare Effekte
  - 3D-Membranstrukturen
  - **■** Sensorkennlinie

- **B.) Dynamische FEM-Berechnungen** 
  - Modalanalyse
  - Kraft-Frequenz-Kennlinie
  - Frequenzganganalyse
  - Temperaturabhängigkeit

# A.) Statische FEM-Berechnungen

**Beispiel:** piezoresistiver Silizium-Drucksensor

### **■** Funktionsprinzip:

Druckbeaufschlagung p ⇒ Membranauslenkung ⇒

 $\Rightarrow$  Membranspannung  $\sigma \Rightarrow$  Widerstandsänderung

#### Sensorkennlinie ist charakterisiert durch:

- Druckempfindlichkeit
- Linearität
- Temperaturempfindlichkeit
- Überlasteigenschaft

#### ■ Einflußgrößen:

- Materialeigenschaften
- Kristallorientierung
- Membrangeometrie
- Widerstandsdesign
- Aufbau- und Verbindungstechnik

### FEM-Lösung (zweidimensionales Modell)

$$[K] \cdot \{u\} = \{F\}$$

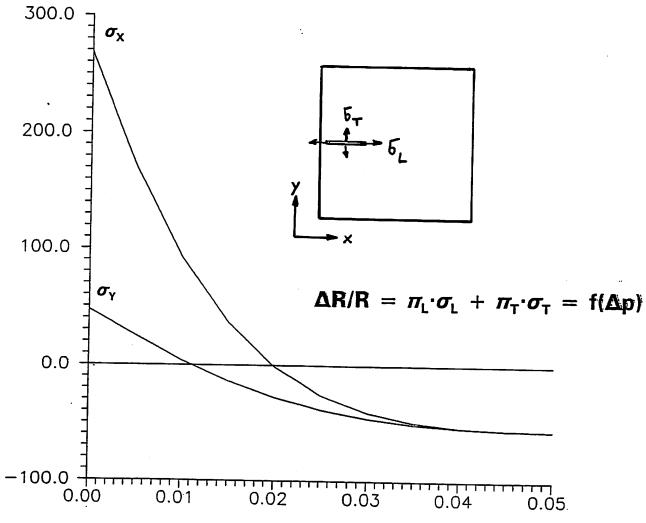
## Berechnung einer dünnen Silizium-Membranstruktur:

• Membranabmessung:  $100 \mu m \times 100 \mu m$ 

• Membrandicke:  $h = 1 \mu m$ 

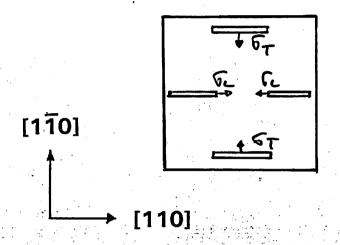
• Druckbeaufschlagung:  $\Delta p = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ 

#### Spannungen (N/mm²)



Membranseitenlänge (mm)

# Beispiel: • quadratische Si(100)-Membran



Widerstandslayout

p-dotierte Si-Widerstände in < 110 > -Richtung:

$$\Pi := \pi_{L} \approx -\pi_{T} \approx 7 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$$

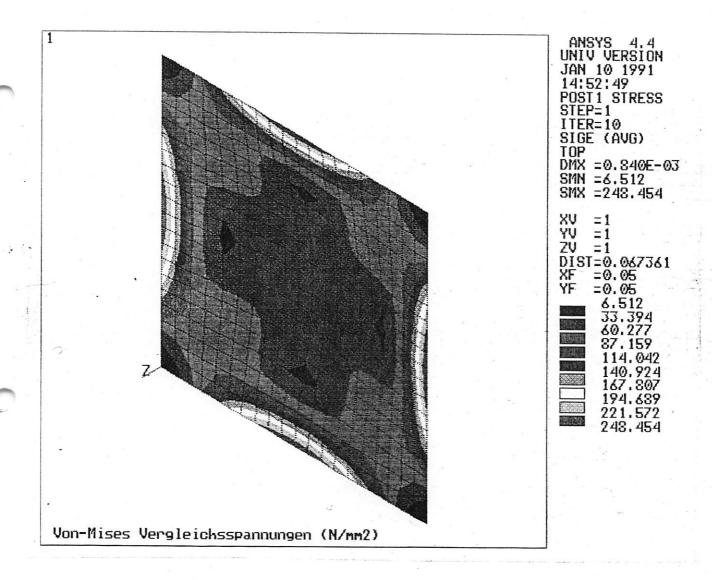
- trans. und long. Widerstandsdesign
- Wheatstonesche Brückenschaltung:

$$\Delta R/R \approx \Pi \cdot (\sigma_L - \sigma_T) \approx \Pi \cdot \sigma_L (1 - v)$$

# Berechnete Spannungsverteilung

• max. Zugspannung:  $\sigma_X \approx 2.7 \cdot 10^8 \text{ Pa}$ 

• max. Auslenkung:  $U_z \approx 0.8 \mu m$ 



Positionierung der piezoresistiven Widerstände im Bereich größter Biegespannungen

## 3.) Nichtlinearität der Kennlinie

■ Membran-Nichtlinearität:

Dehnung der neutralen Ebene durch zusätzliche innere Zugspannung  $\sigma_{\text{Zug}}$  (  $\sim$  p<sup>2</sup> · (a/h)<sup>6</sup> )

FEM: große Auslenkungen (≈ Membrandicke)

- ⇒ Spannungsversteifung der Membran
- Nichtlinearität des piezoresistiven Effektes:

$$\Delta \rho_i / \rho = \sum_{k,m} \pi_{ik} \cdot \sigma_k + \pi_{ikm} \cdot \sigma_k \cdot \sigma_m + \dots$$

(Kompensation durch eine Wheatstone-Brücke mit long. <u>und</u> trans. Widerstandsdesign)

■ temperaturbedingte Nichtlinearitäten:

FEM: temp.abh. Materialeigenschaften: Eik(T)

#### Finite-Elemente-Modellierung:

- ⇒ Minimierung des Linearitätsfehlers NL
- ⇒ Maximierung der Druckempfindlichkeit S

# Nichtlineare FE-Berechnungen

- Material-Nichtlinearität (anisotroper E-Modul)
- verschiedene Materialien (Si, SiO<sub>2</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Pyrex ...)
- Spannungsversteifung der Membran:  $K = f(\Delta p)$
- große Auslenkungen ( ≈ Membrandicke)
- temperaturabhängige Materialeigenschaften

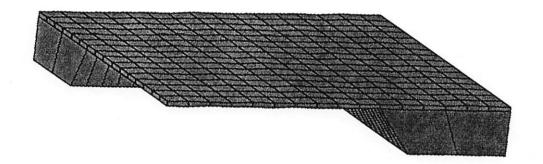
FEM ⇒ Iterative Lösungsalgorithmen nötig

### 3D-Membranstrukturen

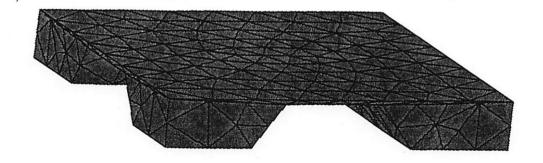
Berücksichtigung von:

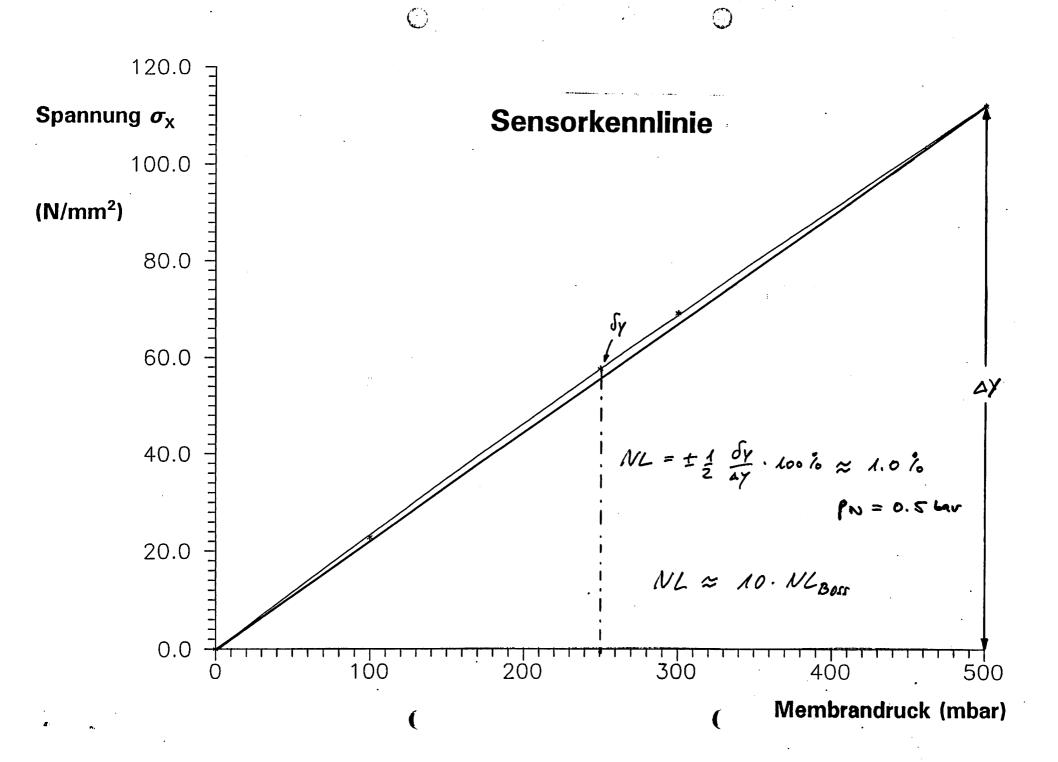
- Membraneinspannung
- Membranstrukturierung
- Materialanisotropie

ebene Si(100)-Membran



Si(100)-Membran mit einfach-BOSS





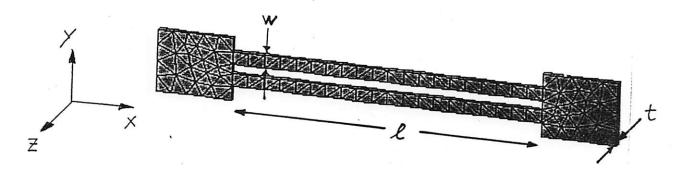
# B.) Dynamische FEM-Berechnungen

#### Beispiel:

Quarzdoppelstimmgabel als resonanter Kraftsensor

#### **■** Funktionsprinzip:

Kraftbeaufschlagung  $\Rightarrow$  Resonatorvorspannung  $\Rightarrow$  Resonanzfrequenzänderung  $\Delta f$ 



- $\bullet l = 5 \text{ mm}, w = 0.2 \text{ mm}, t = 0.1 \text{ mm}$
- anisotroper E-Modul (Z-Schnitt)
- Eigenfrequenzen:  $f \sim w/l^2 \cdot \sqrt{(E/\rho)}$

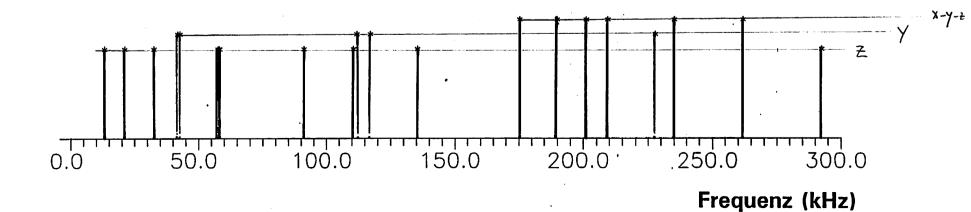
#### 1.) Modalanalyse:

$$[M] \cdot \{\ddot{\mathbf{u}}\} + [K] \cdot \{\mathbf{u}\} = \mathbf{0}$$

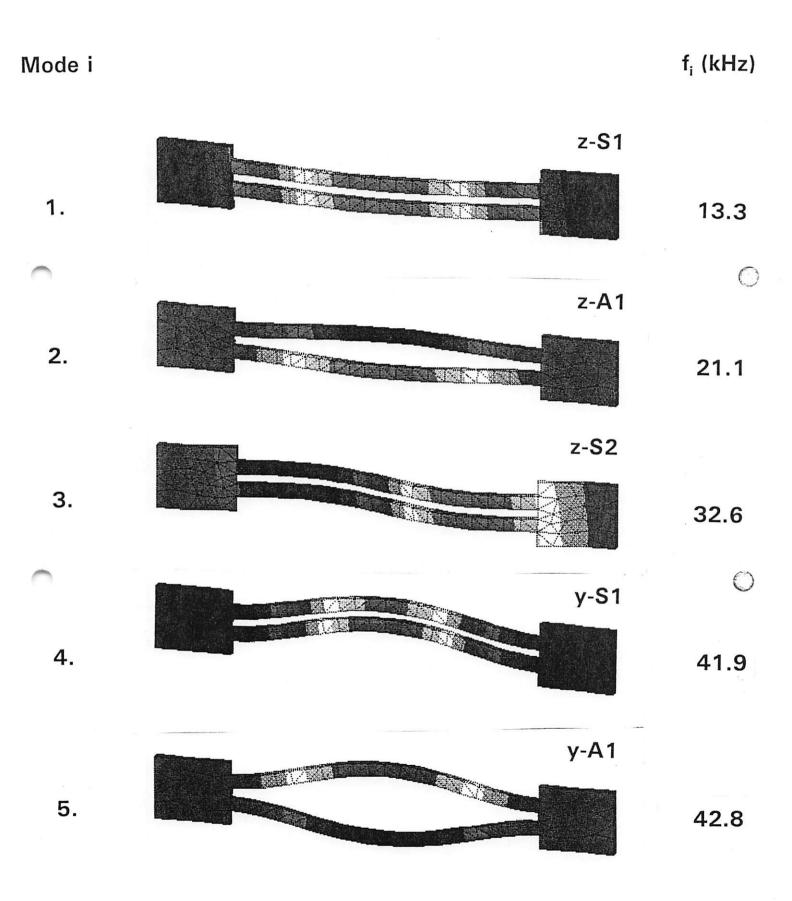
- Berechnung der Eigenfrequenzen fi
- Berechnung der Eigenschwingungsformen

# Modenspektrum der Quarz-Doppelstimmgabel

- Biegeschwingungen in z-Richtung
- Biegeschwingungen in y-Richtung
- überlagerte Schwingungszustände (x-y-z)



# Eigenschwingungsformen



# 2.) Kraft-Frequenz-Kennlinie

• Steifigkeitsänderung infolge Vorspannung S:

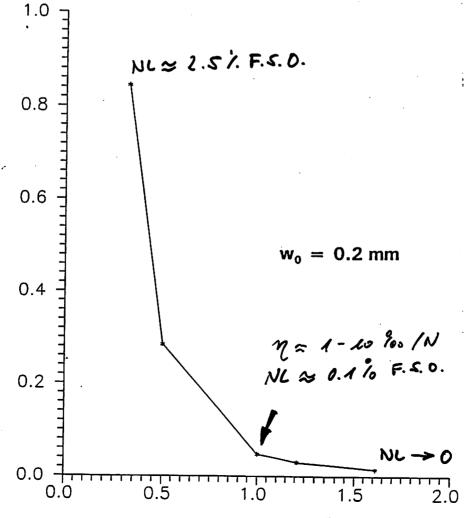
$$[M] \cdot \{\ddot{u}\} + ([K] + [S]) \cdot \{u\} = 0$$

• Kraftempfindlichkeit  $\eta = \Delta f/\Delta \sigma \cdot 1/f_i = f(S)$ 

Abhängigkeit der Kraftempfindlichkeit  $\eta$  von der Stimmgabelbreite w:

$$\eta \sim 1/E \cdot (I/w)^2 \cdot F/(w \cdot t)$$

Empfindlichkeit (arb. units)



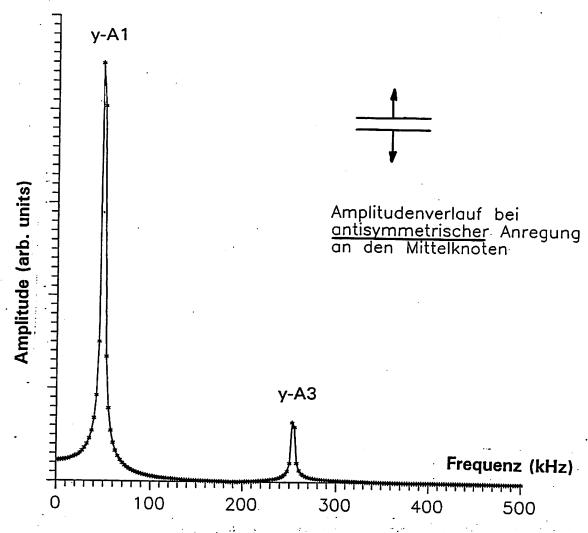
Stimmgabelbreite w/w<sub>0</sub>

# 3.) Frequenzganganalyse

Berechnung des Amplitudenspektrums A(f):

$$[M] \cdot \{\ddot{u}\} + [C] \cdot \{\dot{u}\} + [K] \cdot \{u\} = \{F(t)\}$$

(mechanische Anregung F(t), konstante Dämpfung)



Bestimmend für mikromechanischen Resonator:

- mechanische Schwingungsgüte Q (~1/Dämpfung)
- Unimodalität im Arbeitsbereich

# 4.) Temperaturabhängigkeit

Berechnung der Temperaturabhängigkeit der Resonanz-frequenz  $f_0(T)$  des Schwingungsmodes y-A1:

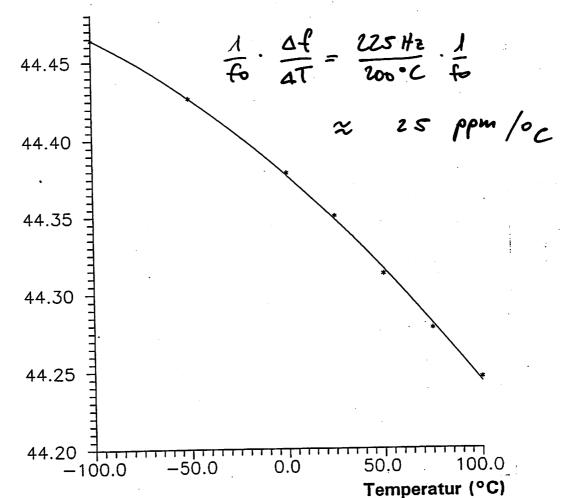
• therm. Ausdehnung:

$$\alpha = f(T) \Rightarrow I = I(T)$$

• E-Modul cik:

$$c_{ik} = f(T) \Rightarrow [K]$$

Frequenz (kHz)



Temperaturverhalten abhängig von:

- Quarz-Kristallschnitt
- Resonatorabmessungen

## Zusammenfassung

Am Hahn-Schickard-Institut für Mikro- und Informationstechnik wurde mit Hilfe von FEM-Berechnungen untersucht:

- Verhalten miniaturisierter Si-Drucksensoren (Membran-Abmessungen:  $100 \mu m \times 100 \mu m$ )
- Verbesserung der Linearität bei piezoresistiven Drucksensoren durch Strukturierung der Membranen
- Einsatzmöglichkeiten der dynamischen FEM-Berechnungen für resonanten Sensoren unter Einbeziehung thermischer und nichtlinearer Effekte

# **Ergebnisse**

Zur Modellierung mikromechanischer Sensoren wurden für die gezeigten Anwendungen parametrisierte FE-Modelle erstellt.

#### Diese ermöglichen:

- 1.) Modellierung von Sensorkonzepten
- 2.) Optimierung des Sensordesigns
- 3.) Berücksichtigung prozeßtechnischer Einflüsse